

江苏微导纳米科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微导纳米”）全体股东利益，进一步提升公司经营效率，增强市场竞争力，提升公司投资价值，公司于 2026 年 4 月 29 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年，公司以该行动方案为纲领，全面推进各项举措落地，在聚焦主业持续增强核心竞争力、落实股东回报、维护投资者合法权益等方面均取得了阶段性积极成果，现将行动方案相关措施的实施情况及效果报告如下：

一、聚焦薄膜沉积设备主业，持续增强核心竞争力

公司坚持“创新驱动”核心发展导向，聚焦半导体与光伏两大主业，并前瞻布局新兴领域。面对半导体行业高景气与光伏行业周期性调整并存的局面，公司通过持续优化业务结构、强化技术研发、提升运营效能，积极把握半导体市场机遇，主动应对光伏行业波动，推动整体业务稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 118,925.42 万元，同比增长 13.27%；归属于上市公司股东的净利润为 10,244.92 万元，扣除非经常性损益的净利润为 6,015.57 万元；分业务看，半导体业务实现高速增长，成为公司核心增长极：半导体设备收入 62,854.53 万元，同比增长 224.77%，占主营业务收入比重提升至 53.11%；半导体新增订单占全部新增订单比例超过 85%，增量主要来自存储领域客户。光伏业务方面，受行业整体调整影响，光伏设备收入为 38,184.07 万元，同比下降 52.48%。新兴领域持续布局，为未来发展培育新的增长点。

1、半导体领域业务高速增长，成为公司核心增长极

报告期内，全球半导体行业延续高景气增长态势，行业需求持续旺盛，国内半导体产业链自主可控进程加速推进，高端薄膜沉积设备国产化替代需求进一步释放。公司多款 ALD 和 CVD 设备获得重点客户验证和量产导入，核心产品的量产规模持续扩大，新产品与新技术市场渗透率稳步提升，半导体设备新签订单规模再创新高。ALD 设备方面，由逻辑芯片、DRAM、3D NAND、新型存储、先进封装等主流应用场景成功拓展至硅基电容等新兴应用场景，并在前沿技术领

域持续取得突破。CVD 设备方面，公司持续攻坚，完成下一代高温 Carbon、DLC(类金刚石碳)、HDC(高密度碳)、WDC(钨掺杂碳)等多种新型碳膜及掺杂碳膜设备及工艺的开发，在原有高温碳膜设备基础上开发出新型 CVD 设备，新设备具备沉积更高蚀刻选择比薄膜的能力，满足客户新一代产品的技术需求，进一步巩固公司在该领域的竞争优势。同时，公司持续推进对其它类型 CVD 设备技术和市场的拓展，其中 LPCVD 等产品已经逐步获得产业链重要客户的量产重复订单。

存储领域：公司作为国内 ALD 与高端 CVD 设备的主要供应商，相关设备已广泛应用于国产存储芯片量产产线，相关工艺技术对推动 DRAM、3D NAND 等存储芯片技术的迭代与产业化具有关键支撑作用，伴随存储芯片 3D 结构堆叠层数的持续提升及客户产能规模的加速扩张，相关设备需求有望持续放量。

逻辑芯片领域：公司与国内主流厂商保持着稳定合作关系，多款设备已通过客户严格的技术验证，关键指标达到国际先进水平，能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。随着国内市场对高端国产薄膜沉积设备需求的增长，该领域业务有望保持增长态势。

先进封装领域：公司积极推动相关设备在客户端验证，并与多家潜在客户开展技术交流。产品采用独特低温控制技术，在保证薄膜高质量沉积的同时，满足先进封装技术低热预算、高晶圆翘曲度、厚膜沉积等低温高质量薄膜需求，适配 Chiplet、2.5D/3D 封装等先进封装技术对薄膜沉积设备提出的全新技术要求。先进封装技术是提升芯片整体性能的重要路径，市场发展潜力巨大。公司作为国内少数具备该领域设备研发与生产能力的企业之一，相关业务预计将获得良好的发展机遇。

在半导体领域，公司将继续利用现有的核心技术，持续拓展市场空间，保持在 ALD 和 CVD 等高端薄膜沉积设备市场的竞争优势，瞄准国内外半导体先进技术和工艺的发展方向，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台，持续丰富产品矩阵，满足客户新器件、新架构、新材料的工艺需求，提供多场景全方位解决方案，覆盖逻辑、存储、先进封装、化合物半导体、新型显示等细分应用领域，满足国内先进半导体下一代技术迭代的需求，从而占据技术的最前沿，引领行业创新发展。

2、光伏业务处于产能出清与价值重构的关键时期，新兴领域布局稳步推进

光伏行业正处于产能出清与价值重构的关键时期，阶段性供需错配矛盾仍未完全化解，产业链盈利压力对设备验收节奏形成一定影响。公司光伏核心设备市占率稳定，当前正积极应对行业变化，围绕 TOPCon+升级改造及 TBC 增量市场进行布局，为光伏能耗新国标落地后，行业设备的技术改造和产能升级需求做好准备；进一步完善了包括全钙钛矿叠层/晶硅钙钛矿叠层、异质结（HJT）等新兴应用电池技术在内的技术储备。同时，持续跟进现有订单的验收，提升存货周转率，加强应收账款管理，确保现金流的稳定。

在钙钛矿电池领域，公司是国内少数实现 ALD、磁控溅射、蒸镀等核心真空工艺设备全覆盖的供应商之一。公司自主研发的 ALD 设备是制备高性能柔性钙钛矿电池的关键装备，在同类产品中市场占有率领先，已多次助力客户刷新钙钛矿组件效率纪录。报告期内，公司多款应用于新型高效电池技术的设备获得客户验证，并逐步进行技术升级以匹配客户未来需求，抢占量产先机。

除在半导体和光伏领域外，ALD 技术在固态电池和新型显示等新兴领域同样展现出关键应用价值。在固态电池领域，ALD 技术可用于电解质薄膜制备、界面缓冲层构筑和锂金属负极保护，从而有效提升库伦效率与循环稳定性；在新型显示领域，ALD 技术凭借原子级的厚度控制精度与优异的薄膜均匀性，可满足硅基 OLED 器件中钝化层、封装层等关键薄膜的沉积需求。公司正持续加大在上述新兴领域的前沿化开发力度，为公司未来发展打造新的收入增长极。

3、强化创新引擎，扩大半导体研发投入，加速新品推出

报告期内，公司坚持创新驱动，继续加大前沿新技术、新产品的研发投入力度，有序推进新产品的开发与导入。2026 年 3 月，公司携新一代 iTomic PE 系列等离子增强原子层沉积系统、iTomic SPX 系列空间型原子层沉积系统、iTronix PE 系列等离子体增强化学气相沉积系统等新产品亮相 SEMICON China 2026。上述三款产品采用独特的技术工艺，能够分别适用于逻辑、存储、先进封装等多领域的需求，展现了公司在薄膜沉积核心赛道的差异化技术壁垒与前瞻布局。2026 年 8 月，公司 iTronix MTP 等离子体化学气相沉积装备成功入选江苏省首台（套）重大装备清单，彰显公司强劲的创新硬实力。

较高水平的研发投入和核心研发团队是保障公司核心竞争力的关键，也是

推动公司业务持续发展的根本。报告期内，公司研发投入 24,518.80 万元，较上年同期的 15,317.22 万元增长 60.07%，占同期公司营业收入比例为 20.62%。为健全长效激励机制，进一步凝聚核心人才，促进公司半导体业务的战略发展，报告期内公司向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票，授予对象侧重核心技术人员和研发人员，有效实现员工价值与企业价值绑定。

公司持续加强知识产权保护与专利布局。专利成果方面，报告期内新增专利授权共计 48 项，累计专利授权达到 298 项；新增专利申请共计 91 项，累计专利申请达到 897 项，荣获第 26 届中国专利奖（优秀奖），技术创新能力获得国家级认可。商标布局方面，围绕“微导”“LEADMICRO”核心品牌标识，完成多维度、全覆盖的商标战略布局，同步搭建完善的防御性商标保护体系，有力保障了品牌资产安全。

4、高效利用募集资金并持续推进募投项目，前瞻性产能扩充稳步推进

为保障设备规模化交付能力，公司正积极推进 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的实施进程，提升薄膜沉积设备的生产能力、研发能力及科技成果转化能力。报告期内，募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”实施加速推进，投资进度超 60%。募投项目具体进展请参考公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

同时，公司持续深化精益生产理念，升级优化模块化、均衡化生产模式，推动数字化管理向深度渗透，逐步完善智能工厂制造体系，提升人均生产产值。供应链管理环节，面对国际贸易局势变动引发的全球产业链调整，公司进一步加强了在需求预测、库存管理和供应商管理等方面的运营，构建完善、稳定、可控的全球供应链体系。通过战略性采购、联合开发、扩大供应商储备等举措，逐步构建起自主可控、安全可靠、具备高韧性的供应链生态。

2026 年上半年，公司主业发展稳定，半导体业务发展迅速，创新能力得到了持续强化，募投项目有序开展，产能支撑能力得到大幅度的提升。

二、坚定落实股东回报计划，持续分享公司发展红利

1、持续、稳定的现金分红，保障股东权益

公司高度重视股东回报，致力于在稳健与持续业绩增长的前提下，保持股东

回报水平的长期、稳定，提升投资者获得感。报告期内，公司加快推进 2025 年度权益分派的实施，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.44 元（含税），共计派发现金红利 6,634.91 万元（含税）。本次分红既兑现了与股东共享成果的承诺，也为公司后续扩产、研发留足充足资金，切实履行了公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2、持续强化市值管理工作，维护资本市场形象

报告期内，公司基于已建立的市值管理体系积极维护公司市值。根据《公司市值管理制度》，公司董事会是市值管理工作的领导机构，证券部负责市值管理工作具体执行，联合其他职能部门积极配合与支持，形成“战略决策层-统筹执行层-赋能支持层”的市值管理架构，积极落实市值管理主体责任。

同时，公司积极维护资本市场形象，建立了完善的舆情监测系统，实时关注财经和产经媒体报道、社交媒体动态以及投资者反馈。通过上述措施，确保公司动态掌握市场方面报道，便于及时了解有关媒体信息，辅助公司及时对相关报道和市场传闻进行澄清。

公司将继续聚焦主业的同时，适时开展资本运作与股权激励等，增强投资者信心，积极引入长期耐心资本，优化股权结构，健全舆情监控与应对，维护市值稳定，努力为投资者创造可持续的长期回报。

2026 年上半年，公司如期完成 2025 年度权益分派，切实兑现了与股东共享发展成果的承诺，同时依托已建立的市值管理制度，持续强化舆情监测与应对能力，维护资本市场形象，为后续市值稳健发展提供了制度保障与执行基础。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

1、“三会”运作规范高效

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，将推动股东会、董事会的规范化、高效化建设作为重要任务，进一步完善法人治理和内部控制体系。2026 年上半年，公司共召开 1 次股东会，5 次董事会，6 次董事会专门委员会会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，切实提高了公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2、持续加强内部审计和风险控制

2026 年上半年，公司审计部深入业务层面积极拓展专项审计范围，强化对重点业务领域风险管控。报告期内累计开展专项审计 6 项，涉及直接材料采购、工程建设项目、研发设计变更等，已出具专项审计报告 6 份，确认审计改善项 20 项，所有审计发现均与业务部门沟通，并就审计整改达成一致，形成整改督导台账，按期确认整改完成情况。通过持续加强内部审计，不断推进内部控制在各个部门和业务环节的完善与深入，构建相互融合、协同高效、全面覆盖的内控体系。

3、ESG 治理持续深化，促进可持续发展

报告期内，公司持续完善 ESG（环境、社会及公司治理）体系，凭借在可持续发展各方面的良好表现，被多家机构覆盖和评级，秩鼎 ESG 评级位居 A 股同行业 198 家公司前 10 名。公司于 2026 年 4 月发布第二份 ESG 报告，在治理架构、商业道德、信息安全、创新驱动等方面实现全面披露。具体内容请参考公司 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司将持续深化 ESG 治理体系建设，推动 ESG 理念全面融入日常运营与决策流程，紧密对标监管指引要求及优秀实践案例，从“决策层、执行层、支持层”共同发力，驱动公司实现可持续发展。

2026 年上半年，公司“三会”运作规范高效，有效发挥了专门委员会和独立董事的决策支撑作用，内部审计覆盖面持续拓展，审计整改闭环管理机制有效运转，内控体系进一步完善，ESG 体系建设取得显著进展。

四、加强投资者沟通，高质量信息披露

报告期内，公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，并始终将其作为提升公司透明度和树立资本市场良好形象的关键。不仅致力于确保所有相关活动的严格合规运作与精准高效执行，更通过积极主动、透明坦诚的沟通，向资本市场清晰传递公司价值与发展战略，旨在赢得投资者的长期信任与价值认同。公司已连续两年在上海证券交易所信息披露工作评价中获得“A”级。

1、坚守合规意识，持续提升信息披露质量

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，对信息披露实行清单管理和多层审核，报告期内累计披露定期报告、临时公告 79 份，保持“零差错”，

信息披露工作规范。

同时，公司通过官方微信公众号、财富号、同花顺平台同步发布可视化的一图读懂年度报告、季度报告和 ESG 报告，并实现精准推送，以图文并茂的形式将关键信息浓缩提炼，浅显易懂地向市场传达公司财务状况及经营亮点，提高“悦读性”。

2、立足互动互信，深化投资者关系管理

公司保持业绩说明会常态化召开，将业绩说明会作为定期报告发布后企业管理层与投资者沟通的重要渠道之一。2026 年 5 月 6 日，公司参加上证路演中心“十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体设备行业集体业绩说明会”，针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

另一方面，积极通过其他多种渠道增进与投资者的交流互动。报告期内，公司通过接待投资者现场调研、参加券商策略会、反路演等多种形式，与投资者交流，增进投资者对公司的了解和信任，树立良好的资本市场形象。公司已连续两年参加上海证券交易所“我是股东”走进沪市上市公司品牌活动，让投资者近距离了解我国半导体设备产业自主可控的喜人进展。

在股东会召开过程中，公司积极为全体股东特别是中小股东参与股东会提供便利，合理安排会议议程，保障投资者与董事、高级管理人员的充分交流时间，并全面提供网络投票渠道，确保全体股东的表决权、知情权等合法权益得到充分尊重与落实。

2026 年上半年，公司保持着高质量的信息披露，有序开展了投资者交流工作，保障了中小股东便利参与股东会的权利，资本市场透明度和价值认同度进一步提升。

五、其他

2026 年下半年，公司将积极执行行动方案中的各项举措，持续评估实施效果并根据实际情况做出相应的动态调整。公司将稳健推进既定战略，精准优化经营举措，并强化信息披露。始终聚焦主业，致力于提升核心竞争力、盈利与抗风险能力，以卓越业绩和规范治理回馈投资者，履行上市公司责任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日